

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
|  穗权物联 SIOT | 文件名称: BWMZB07 系列 智能模组产品规格书 | 发布日期: 2023.10.25 |
| | 文件编号: VC-QW-0A-2023-10-01 | 实施日期: 2023.10.25 |

BWMZB07 系列

智能模组产品规格书

编制/日期: 2023-10-24

审核/日期: 2023-10-25

批准/日期: 2023-10-25

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 一、智能模组 BWMZB07 子系列产品 | 1 |
| 二、智能模组产品概述 | 2 |
| 1 产品简介 | 2 |
| 2 产品技术参数 | 2 |
| 3 应用领域 | 3 |
| 4 命名规则 | 3 |
| 三、模组接口 | 4 |
| 1 尺寸封装 | 4 |
| 2 模组 IO 引脚接口定义 | 6 |
| 3 DEBUG 功能 | 7 |
| 四、射频参数 | 8 |
| 1 基本射频特性 | 8 |
| 2 发射性能 | 8 |
| 3 接收性能 | 8 |
| 五、天线信息 | 9 |
| 1 天线信息 | 9 |
| 2 降低天线干扰 | 9 |
| 六、封装信息及设计参考 | 10 |

| | |
|----------------------|----|
| 1 机械尺寸 | 10 |
| 2 侧视图 | 10 |
| 3 设计参考图 | 11 |
| 4 电路原理图 | 11 |
| 5 PCB 封装图-SMT | 12 |
| 七、生产注意事项..... | 13 |
| 八、模组 MOQ 与包装信息 | 13 |
| 九、联系方式 | 14 |

一、智能模组 BWMZB07 产品

| 模组系列 | 功能特点 |
|---------|---|
| BWMZB07 | 存储: 1024kB 天线: 板载天线 屏蔽罩: 有屏蔽罩 耐温: 正常 |

二、智能模组产品概述

1 产品简介

BWMZB07 是上海熵权物联科技有限公司开发的一款 ZigBee 无线通讯智能模组，支持 ZigBee3.0。采用了 Silicon Labs (芯科科技) 高集成度的无线射频处理器芯片 EFR32MG21A020 系列芯片，具有无线传输功率高，接收灵敏度强，低功耗，组网能力强等优点和特性，为 ZigBee 连接提供了完美的解决方案。



2 产品技术参数

| 技术参数 | 参数值 |
|--------|--------------------------------|
| 芯片型号 | EFR32MG21A020F1024IM32-B |
| 主控 | 高性能 32 位 80MHz ARM Cortex®-M33 |
| Flash | 1024kB |
| RAM | 96KB |
| 支持协议 | ZigBee 3.0&BLE5.0 |
| 工作频率 | 2400 ~ 2480 MHz |
| 输出发射功率 | Max: 20dBm |
| 接收灵敏度 | Max: -102.5dBm |
| 调制方式 | DSSS QPSK |
| 工作电压 | 2.0 V ~ 3.6 V |
| 发送电流 | Max: 27mA (00dBm) |
| | Max: 63mA (10dBm) |
| | Max: 182mA (20dBm) |
| 接收电流 | Max: 10.91mA (250Kbps) |
| 静态电流 | 4.5mA (空闲 EM0) |
| | 6.2uA (睡眠 EM2) |
| 标准安全性 | AES 128/256 |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C |
| 环境湿度 | 10% ~ 90%不结露 |
| 技术认证 | FCC & CE & SRRC |

3 应用领域

- 智慧灯光、照明
- 智慧校园
- 智慧楼宇
- 智慧家居
- 智慧家电
- 智慧插座
- 智慧养老

三、模组接口

1 BWMZB07 外观

BWMZB07 共有 2 排引脚，引脚间距为 2mm

BWMZB07 尺寸大小： $18\pm0.4\text{mm (L)} \times 15\pm0.4\text{mm (W)} \times 2.5\pm0.2\text{mm (H)}$

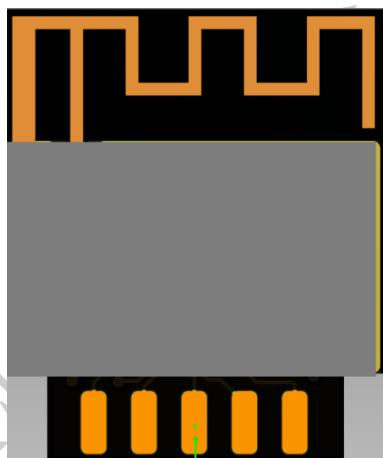


图 3-1 模块有屏蔽罩正面图

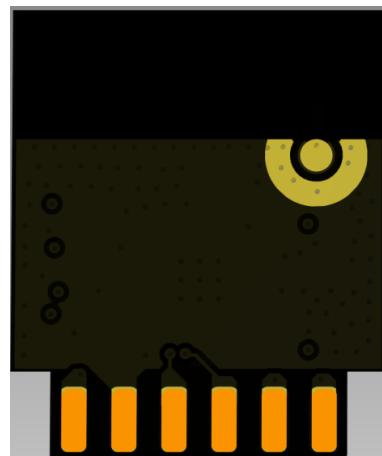


图 3-2 模块有屏蔽罩背面图

2 模组 IO 引脚接口定义

| 引脚编号 | 芯片功能 | 模块功能 | 功能说明 | |
|------|------|-------------|--------|-------------------|
| 1 | NULL | PB00(GPIO) | IO/PWM | 做 GPIO 使用, 可接拨码开关 |
| 2 | PA01 | DC/PA01 | DC | DEBUG CLOCK |
| 3 | PA02 | DD/PA02 | DD | DEBUG DATA |
| 4 | NULL | PA03(GPIO) | RXD | 串口接收口 |
| 5 | NULL | PA04(GPIO) | TXD | 串口发送口 |
| 6 | VCC | PAVDD/RFVDD | VDD | 直流电源 (1.85~3.6V) |
| 7 | GND | GND/PAVSS | GND | 接地 |
| 8 | NULL | PA06(GPIO) | PWM | 调光 PWM 口 |
| 9 | NULL | PA05(GPIO) | PWM | 调光 PWM 口 |
| 10 | NULL | PA00(GPIO) | IO/PWM | 做 GPIO 使用, 可接拨码开关 |
| 11 | NULL | PB01(GPIO) | IO/PWM | 做 GPIO 使用, 可接拨码开关 |

表 3-1 引脚功能定义

3 DEBUG 功能

烧录调试管脚功能采用 7、2、3、4、5、6 引脚 (功能说明见表 3-2)

| 引脚编号 | 芯片功能 | 功能说明 |
|------|------|--------------|
| 7 | GND | 接地 |
| 2 | DC | DEBUG CLOCK |
| 3 | DD | DEBUG DATA |
| 4 | RXD | UART TTL RXD |
| 5 | TXD | UART TTL TXD |
| 6 | VDD | 电源 (3.3V) |

表 3-2 烧录固件功能

四、射频参数

1 基本射频特性

| 参数项 | 详细说明 |
|-----------|----------------|
| 工作频率 | 2.405~2.480GHz |
| ZigBee 标准 | IEEE 802.15.4 |
| 数据传输速率 | 250Kbps |

表 4-1 基本射频特性

2 发射性能

| 参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------|-----|-------|-----|-----|
| 最大输出功率 (250Kbps) | | 19.3 | - | dBm |
| 最小输出功率 (250Kbps) | - | -15.2 | - | dBm |

表 4-2 发射性能

3 接收性能

| 参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------|--------|--------|------|-----|
| RX 灵敏度 (250Kbps) | -102.5 | -102.3 | -102 | dBm |

表 4-3 接收性能

五、天线信息

1 天线信息

该款系列模组的天线可选板载天线。

2 降低天线干扰

在 ZigBee 模组上使用 PCB 板载天线时，为确保 ZigBee 性能的最优化，建议模组天线部分和其他金属部件距离至少在 24.5mm 以上。用户 PCB 板在天线区域勿走线甚至覆铜
(绿色标识为覆铜区域，如图 4-1)，以免影响天线性能。

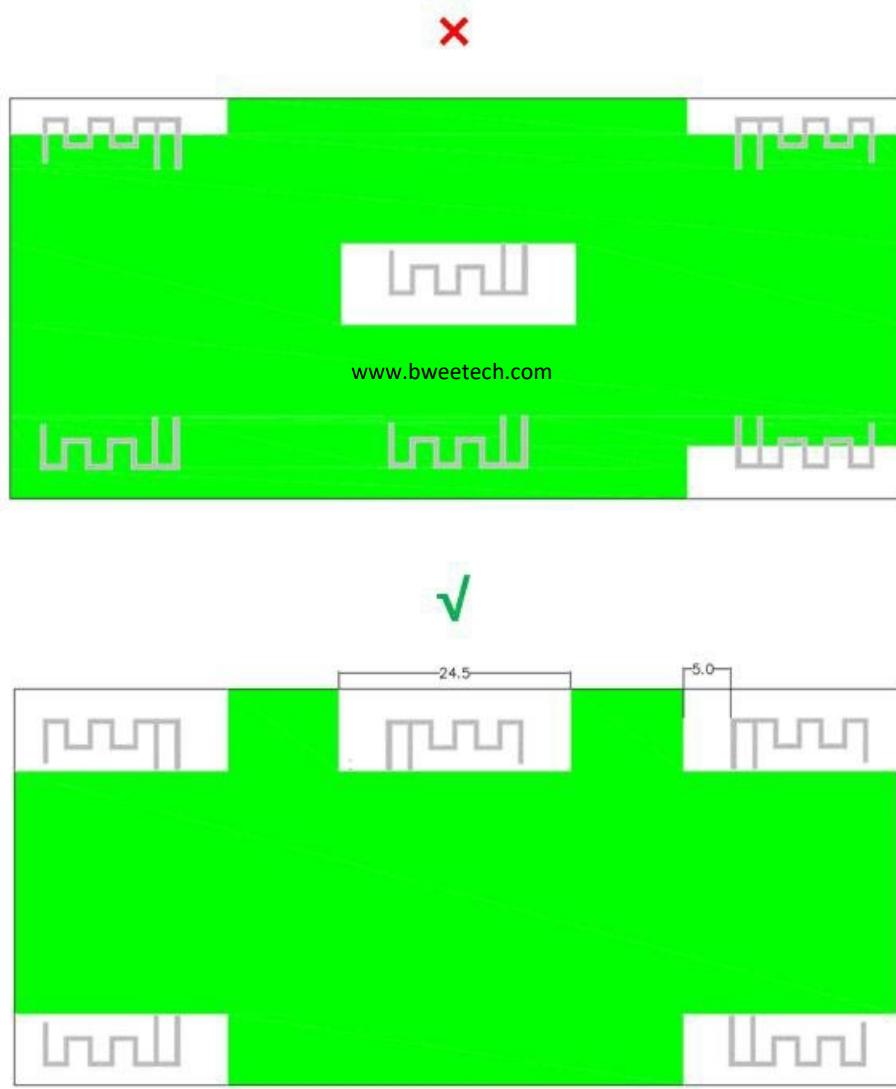


图 5-1 天线干扰区域

六、封装信息及设计参考

1 机械尺寸

- 模块尺寸为：18 x 15mm。模块尺寸、焊盘尺寸如图所示
- 以下模块尺寸公差为 $\pm 0.4\text{mm}$

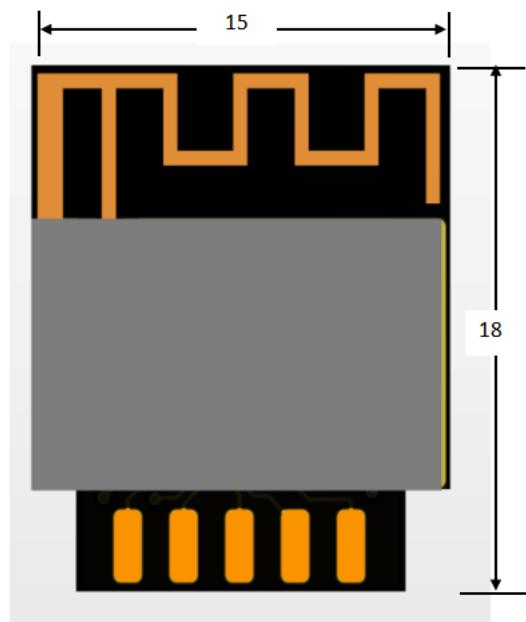


图 6-1 机械尺寸图

2 侧视图

2.1 BWMZB07 带屏蔽罩



图 6-2 模组屏蔽罩侧视图

3 设计参考图

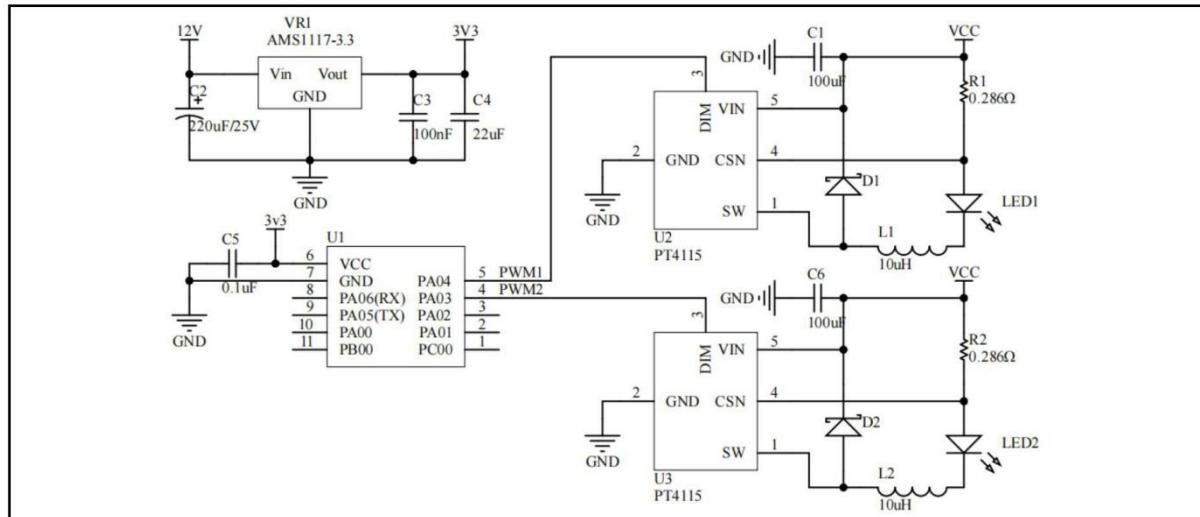


图 6-3 设计参考图

4 电路原理图

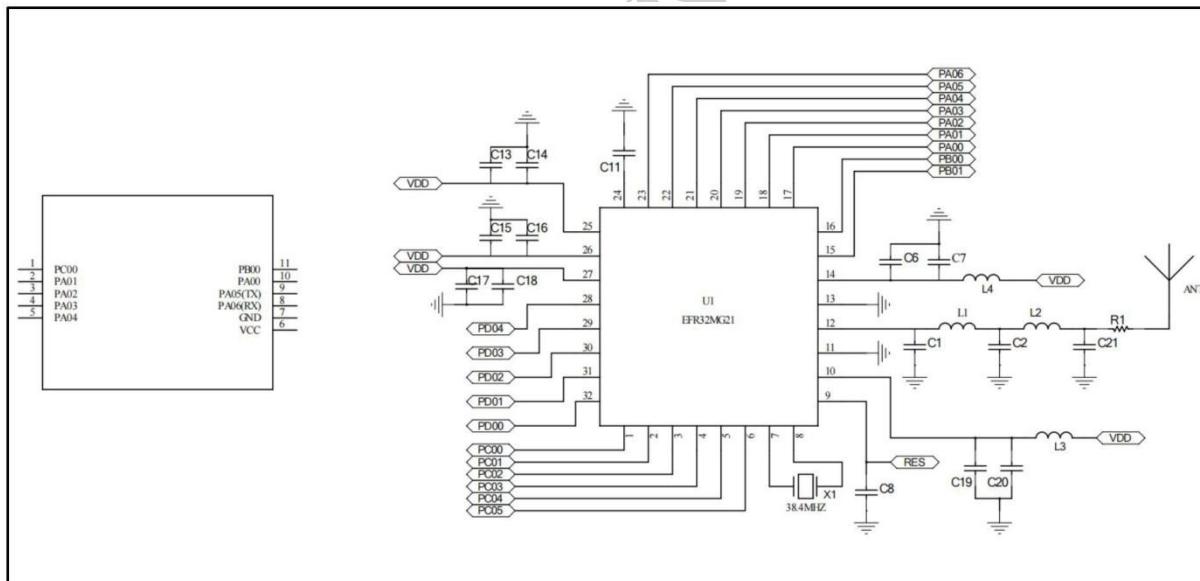


图 6-4 电路原理图

5 PCB 封装图-SMT

5.1 封装尺寸

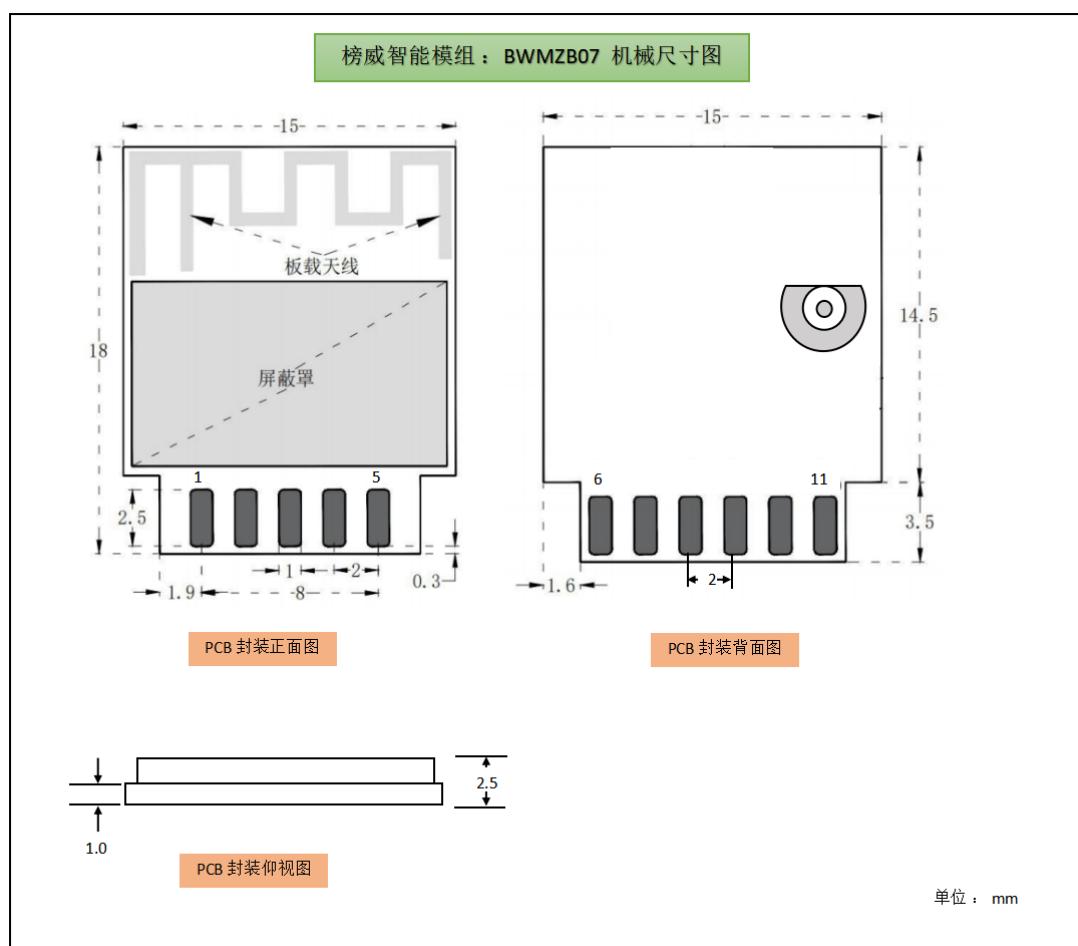


图 6-7 封装尺寸

5.2 引脚定义和限制区说明

七、生产注意事项

1 模块包装的储存期限

- a) 保存期限：12 个月，储存环境条件：在温度 < 40°C，湿度 < 90% R.H
- b) 库存管制：以“先进先出”为原则

2 模块包装拆封后，SMT 组装的时限

- a) 检查湿度卡（如图 6-1）：显示值应少于 20%（蓝色）；如> 30%（红色），表示模块已吸湿气

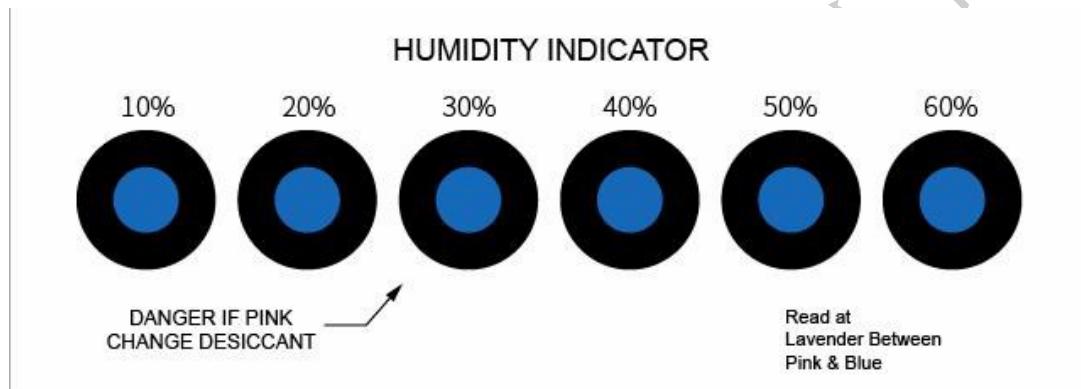


图 7-1 湿度卡检查

- b) SMT 车间环境温湿度管制：在温度 25°C($\pm 4^\circ\text{C}$)，湿度 60%R.H($\pm 20\%$)下作业
- c) 烘烤后，立即用于 SMT 生产，或放入适量干燥剂再密封包装，放入干燥柜内储存

3 拆封后的模块，如未在 48 小时内使用完时

- a) 模块必须重新烘烤，以去除模块吸湿问题
- b) 烘烤温度时间条件
 - 烘烤温度：卷盘包装 60°C；托盘包装 60°C
 - 烘烤时间：卷盘包装 8 小时；托盘包装 4 小时
 - 若烘烤后暴露时间大于 168 小时没有使用完，请再次进行烘烤

八、模组 MOQ 与包装信息

| 产品型号 | MOQ (PCS) | 吸塑盘包装方式 | | 卷带包装方式 |
|---------|-----------|---------|--------|---------|
| | | 每盘模组数量 | 每箱包装盘数 | 每盘模组数量 |
| BWMZB07 | 1K | 80PCS | 25 | 1000PCS |

表 8-1 模组包装信息

九、联系方式

138 168 47486 (同微信)

上海熵权物联技术有限公司
上海市浦东新区宁桥路 615 号 1 号楼 501
<http://www.sq-iot.com>